

EVG301键合机联系电话

生成日期: 2025-10-29

长久键合系统 EVG晶圆键合方法的引入将键合对准与键合步骤分离开来，立即在业内掀起了市场**。利用高温和受控气体环境下的高接触力，这种新颖的方法已成为当今的工艺标准。EVG的键合机设备占据了半自动和全自动晶圆键合机的主要市场份额，并且安装的机台已经超过1500个。EVG的晶圆键合机可提供最/佳的总拥有成本(TCO)并具有多种设计功能，可优化键合良率。针对MEMS、3D集成或gao级封装的不同市场需求，EVG优化了用于对准的多个模块。下面是EVG的键合机EVG500系列介绍。同时，EVG研发生产的GEMINI系统是使用晶圆键合的量产应用的行业标准。EVG301键合机联系电话

**EVG501
晶圆键合机**



岱美仪器技术服务(上海)有限公司
键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

BONDSCALE与EVG的行业基准GEMINIFBXT自动熔融系统一起出售，每个平台针对不同的应用。虽然BONDSCALE将主要专注于工程化的基板键合和层转移处理，但GEMINIFBXT将支持要求更高对准精度的应用，例如存储器堆叠、3D片上系统(SoC)、背面照明的CMOS图像传感器堆叠以及管芯分区。特征：在单个平台上的200mm和300mm基板上的全自动熔融/分子晶圆键合应用通过等离子活化的直接晶圆键合，可实现不同材料，高质量工程衬底以及薄硅层转移应用的异质集成支持逻辑缩放、3D集成(例如M3、3DVLSI)包括背面电源分配、N/P堆栈，内存逻辑，集群功能堆栈以及超越CMOS的采用的层转移工艺和工程衬底。BONDSCALE™ 自动化生产熔融系统的技术数据晶圆直径(基板尺寸)：200、300毫米最高数量或过程模块8通量每小时最多40个晶圆处理系统4个装载口特征：多达八个预处理模块，例如清洁模块、LowTemp™等离子活化模块，对准验证模块和解键合模块XT框架概念通过EFEM(设备前端模块)实现最高吞吐量光学边缘对准模块(Xmax/Ymax=18μm 3σ) EVG301键合机联系电话 EVG的 GEMINI系列，在最小占地面积上，一样利用EVG 最高精度的Smart View NT对准技术。

EVG520 IS 晶圆键合机



岱美仪器技术服务（上海）有限公司

键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVG®850键合机 EVG®850键合机特征 生产系统可在高通量，高产量环境中运行 自动盒带间或FOUP到FOUP操作 无污染的背面处理 超音速和/或刷子清洁 机械平整或缺口对准的预键合 先进的远程诊断 技术数据 晶圆直径（基板尺寸） 100-200、150-300毫米 全自动盒带到盒带操作 预键合室 对准类型：平面到平面或凹口到凹口 对准精度 X 和 $Y \pm 50 \mu m$ $\theta \pm 0.1^\circ$ 结合力：蕞/高5N 键合波起始位置：从晶圆边缘到中心灵活真空系统 $9 \times 10^{-2} mbar$ （标准）和 $9 \times 10^{-3} mbar$ （涡轮泵选件） 清洁站 清洁方式：冲洗（标准），超音速喷嘴，超音速面积传感器，喷嘴，刷子（可选） 腔室：由PP或PFA制成（可选） 清洁介质：去离子水（标准） NH_4OH 和 H_2O_2 （蕞/大）。2%浓度（可选） 旋转卡盘：真空卡盘（标准）和边缘处理卡盘（选件），由不含金属离子的清洁材料制成 旋转：蕞/高3000rpm $5s$

半导体晶圆（晶片）的直径为4到10英寸（10.16到25.4厘米）的圆盘，在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正 P 型半导体或负 N 型半导体的临时形式。硅晶片是非常常见的半导体晶片，因为硅是当夏流行的半导体，这是由于其在地球上的大量供应。半导体晶圆是从锭上切片或切割薄盘的结果，它是根据需要被掺杂为 P 型或 N 型的棒状晶体。然后对它们进行刻划，以用于切割或切割单个裸片或方形子组件，这些单个裸片或正方形子组件可能瑾包含一种半导体材料或多达整个电路，例如集成电路计算机处理器 EVG 键合机软件是基于 $Windows$ 的图形用户界面的设计，注重用户友好性，可轻松引导操作员完成每个流程步骤。

EVG320 自动化晶圆清洗系统



岱美仪器技术服务（上海）有限公司

键合机、光刻机、膜厚仪、干涉仪、轮廓仪、隔振台、位移传感器

EVG®810LT技术数据晶圆直径（基板尺寸）50-200、100-300毫米LowTemp™等离子活化室工艺气体：2种标准工艺气体N₂和O₂通用质量流量控制器：自校准（高达20.000sccm）真空系统9x10⁻²mbar腔室的打开/关闭：自动化腔室的加载/卸载：手动（将晶圆/基板放置在加载销上）可选功能：卡盘适用于不同的晶圆尺寸无金属离子活化混合气体的其他工艺气体带有涡轮泵的高真空系统9x10⁻³mbar基本压力符合LowTemp™等离子活化粘结的材料系统Si/Si/Si/Si/Si热氧化/Si热氧化/Si热氧化/TEOS/TEOS热氧化）绝缘体锗GeO₂的Si/GeSi/Si₃N₄玻璃（无碱浮法）：硅/玻璃，玻璃/玻璃化合物半导体GaAs/GaP/InP聚合物PMMA环烯烃聚合物用户可以使用上述和其他材料的“最佳已知方法”配方（可根据要求提供完整列表Smart View®NT-适用于GEMINI和GEMINI FB让晶圆在晶圆键合之前进行晶圆对准EVG301键合机联系电话

EVG键合机可以使用适合每个通用键合室的砖用卡盘来处理各种尺寸晶圆和键合工艺EVG301键合机联系电话

EVG®510键合机特征 独特的压力和温度均匀性 兼容EVG机械和光学对准器 灵活的设计和配置，用于研究和试生产 将单芯片形成晶圆 各种工艺（共晶，焊料TLP直接键合） 可选的涡轮泵<1E-5mbar 可升级用于阳极键合 开室设计，易于转换和维护 生产兼容 高通量，具有快速加热和泵送规格 通过自动楔形补偿实现高产量 开室设计，可快速转换和维护 200mm键合系统的最小占地面积0.8m² 程序与EVG的大批量生产键合系统完全兼容 技术数据 最大/大接触力 10/20/60kN 加热器尺寸150毫米200毫米 最小基板尺寸单芯片100毫米 真空 标准：0.1毫巴 可选1E-5mbarEVG301键合机联系电话

岱美仪器技术服务（上海）有限公司主营产品有EVG,Filmetrics,MicroSense,Herz,Herzan,Film Sense,Polytechnik,4D,Nanotronics,Subnano,Bruker,FSM,SHB发展规模团队不断壮大，该公司贸易型的公司。公司致力于为客户提供安全、质量有保证的良好产品及服务，是一家其他有限责任公司企业。以满足客户要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供***的半导体工艺设备，半导体测量设备，光刻机 键合机，膜厚测量仪。岱美中国自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。